

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

2024 年拟向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

为满足厦门华联电子股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司厦门华联电子科技有限公司（以下简称“华联科技”）及控股子公司厦门华联半导体科技有限公司（以下简称“华联半导体”）日常运营及经营发展需要，根据公司和子公司 2024 年的经营计划，公司拟向银行申请年度授信最高合计人民币 91,150 万元（含）的综合授信额度，华联科技拟向银行申请年度授信最高不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，华联半导体拟向银行申请年度授信最高不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准（包含但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际/国内贸易融资、保理、商业发票贴现、票据池质押融资、外汇避险等各种融资等），分别列示如下：

1、公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度为人民币 46,150 万元整的最高综合授信，根据银行贷款需要，公司将提供公司名下的翔安区舫阳南路 189 号、189-1 号、189-2 号、189-3 号、189-4 号共计五套工业房地产进行抵押担保；

2、公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度为人民币 6,000 万元整的最高综合授信；

3、公司向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度为人民币 14,000 万元整的最高综合授信；

4、公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度为人民币 10,000 万元整的最高综合授信。

5、公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请授信额度为人民币 5,000 万元整的最高综合授信。

6、公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度为人民币 10,000 万元整的最高综合授信。

8、华联科技拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度为人民币 1,000 万元整的最高综合授信。

9、华联半导体拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请授信额度为人民币 1,000 万元整的最高综合授信，公司为其提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 1,200 万元。

上述 9 笔授信，在授信期限内，授信额度可循环使用，有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议通过之日。

公司上述申请的授信不等于公司的实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款额度、期限、利率等以实际签署的合同为准。

二、业务授权

公司董事会提请股东大会授权董事会决定上述授信融资项下的相关法律文件的具体内容，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

授权期限为：自本次年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会审议通过之日。

三、审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》、《关于公司向中国银行申请授信的议案》、《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》、《关于公司向兴业银行申请授信的议案》、《关于公司向赣州银行申请授信的议案》、《关于公司向光大银行申请授信的议案》、《关于全资子公司向银行申请授信的议案》、《关于公司为控股子公司向中国农业银行申请授信提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

四、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司和子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

(一)《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司
董事会
2024年3月29日